

Halogen-free/High Tg/Low Loss

特性 (Feature)

- 无卤，无锑，无红磷 Tg200℃
Halogen, antimony and red phosphorous free
- 优良的耐热性
Excellent thermal reliability
- 优良的介电性能(Dk=3.8 , Df=0.006)
Low Dk/Df
- 超低的Z轴热膨胀系数
Extremely low Z-CTE
- 良好的耐CAF性能
Anti-CAF capability

应用 (Application)

- 服务器，交换机，基站
Server, Switch, Base station
- 背板
Backplane
- 高性能计算机
High performance computing
- 网络通信
Network and telecom application
- 高复杂度多层板
High complexity multi-layers

板材性能 (Laminate Properties)

Test Item 测试项目		Test Method (IPC-TM- 650) 测试方法	Test Condition 处理条件		Unit 单位	Specification 规格值 (IPC-4101E/130)	Typical Value 典型值
Thermal 热性能	Thermal Stress 热应力	2.4.13.1	Float 288 °C/ Unetched		Sec	≥10	≥240
	Glass Transition (Tg) 玻璃化转变温度	2.4.25	E-2/105 DSC		°C	≥200	210
	CTE/ Z-Axis Expansion Z-轴热膨胀系数	2.4.24	Alpha 1		ppm/°C	≤60	30
			Alpha 2			≤300	160
			50 - 260 °C			≤3.0	1.3
	X/Y CTE X/Y-轴热膨胀系数	2.4.24	40 °C - 125 °C		ppm/°C	——	12/15
	T-260	2.4.24.1	TMA		min	≥30	>60
	T-288	2.4.24.1	TMA		min	≥15	>60
TD(5% weight loss)	2.4.24.6	TGA		°C	≥340	409	
Flammability 燃烧性	UL94	E-24/ 125		Rating	V-0	V-0	
Electrical 电性能	Surface Resistivity 表面电阻	2.5.17.1	C-96/35/90		MΩ	≥10 ⁴	6.3×10 ⁸
	Volume Resistivity 体积电阻	2.5.17.1	C-96/35/90		MΩ-cm	≥10 ⁶	7.4×10 ⁹
	Dielectric Breakdown 击穿电压	2.5.6	D-48/ 50+D-0.5/ 23		kV	≥40	≥45
	Dielectric Constant 介电常数	2.5.5.2	Etched (RC50%)	@ 1 GHz	—	≤5.4	3.9
				@ 10 GHz			3.8
	Loss Tangent 介质损耗	2.5.5.2	Etched (RC50%)	@ 1 GHz	—	≤0.035	0.006
				@ 10 GHz			0.007
	CTI 相对漏电起痕指数	IEC60112	A		V	——	>175
Arc Resistance 耐电弧性	2.5.1	D-48/ 50+D-0.5/ 23		Sec	≥60	126	
Mechanical 机械性能	Peel Strength (1 oz.) 铜箔剥离强度	2.4.8	125 °C		N/mm	≥0.70	1.20
			Float 288 °C/ 10 Sec			≥1.05	1.30
			After Process Solution			≥0.80	1.10
	Flexural Strength 抗弯强度	2.4.4	Length Direction		N/mm ²	≥415	560
			Cross Direction			≥345	470
Moisture Absorption 吸水率	2.6.2.1	D-24/23		%	≤0.5	0.11	

Remarks:
- Typical Values for reference only.
- Standard Values according to IPC-4101E/130
- Typical Value of Specimen thickness is 1.0mm (10*2116)

注:
- 典型值只供参考
- 规格值参照 IPC-4101E/130
- 样品的厚度为 1.0mm (10*2116)

KB-6167GLD 板材清单(Laminate List)

Thickness 厚度(mm)	Size 尺寸(Inch)	Copper foil Type 铜箔类型
0.05-3.20	37" ×49" , 41" ×49" , 43" ×49" 74" ×49" , 82" ×49" , 86" ×49"	Reverse treated copper foil RTF铜箔：1/3OZ—6OZ VLP/HVLP copper foil VLP/HVLP铜箔：1/3OZ—6OZ

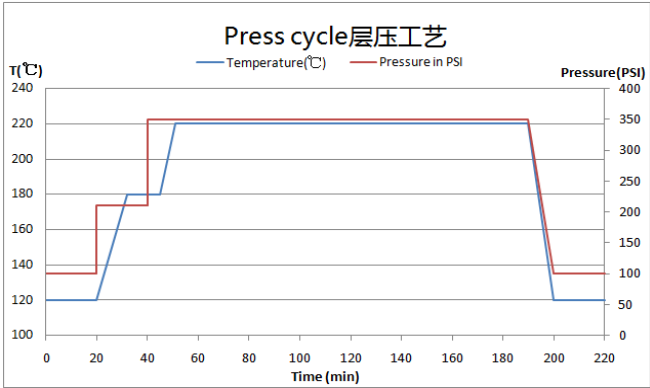
KB-6067GLD 半固化片清单(Prepreg List)

UL Designation UL型号	PP style 类型	R/C(%) 树脂含量	Dk±0.2(10GHz) 介电常数	Df±10%(10GHz) 介质损耗	Thickness(mil) 压合厚度
KB-6067GLD	1037	76±2	3.3	0.007	2.3±0.30
		78±2	3.3	0.007	2.5±0.30
	106	70±2	3.5	0.007	2.1±0.30
		73±2	3.4	0.007	2.3±0.30
		76±2	3.3	0.007	2.5±0.30
	1067	72±2	3.5	0.007	2.7±0.30
		74±2	3.4	0.007	3.0±0.50
	1080	62±2	3.7	0.007	2.8±0.30
		65±2	3.6	0.007	3.1±0.30
		68±2	3.6	0.007	3.4±0.30
	1086	66±2	3.6	0.007	3.7±0.40
		68±2	3.6	0.007	4.0±0.50
	3313	52±2	3.8	0.007	3.6±0.30
		55±2	3.8	0.007	3.9±0.30
		58±2	3.7	0.006	4.1±0.30
	2116	52±2	3.8	0.006	4.7±0.30
		55±2	3.8	0.006	5.1±0.30
		58±2	3.7	0.007	5.6±0.30
	1506	46±2	3.9	0.006	6.4±0.40
		48±2	3.8	0.006	7.0±0.40

KB-6067GLD 半固化片储存(Prepreg Storage)

储存条件(Condition)	有效期(Shelf Life)
Max. 50%RH & Max. 23°C 湿度 < 50% 及 温度 < 23°C	90 days
Max. 5°C(Normal in room temperature for at least 4h before using) 温度 < 5°C (拆包装前需在室温下回温至少4小时)	180 days

压合参数 (Recommended Process)



- Heat-up rate: 1.5-2.5°C/min (80°C-140°C)
热压升温速率: 1.5-2.5°C/min (80°C-140°C)
- Curing time: >100min(> 200°C)
固化时间: >100min(> 200°C)
- Curing pressure: 350±50 PSI
(vacuum hydraulic press)
固化压力: 350±50 PSI
(真空热油压机)

Remarks:
This Technical Information only lists the typical values of particular specification. If the customer needs other specifications, please contact your sales representative for more information.

注:
本产品技术资料只列出指定规格的典型值，如客户需要其他规格的资料，请与您的销售代表联系